**电子科技大学集成电路“强芯铸魂”本研贯通培养特别行动计划**

**特色介绍**

“强芯铸魂”依托学校在集成电路领域的优势学科资源和产教融合资源，充分发挥电子薄膜与集成器件全国重点实验室、国家集成电路产教融合创新平台的能量，聚焦集成电路设计、制造工艺、先进封装以及EDA等核心关键技术，实施集成电路“强芯铸魂”本研贯通培养特别行动计划。

**1、定制化培养**

对于本科一年级入选的学生，在大类基础课基础上，按照项目式专业核心课、个性化专业课、研究性项目硕士课和创新性研究博士课等模块环节进行学习和培养。

全程配备校内校外双导师，按“一院一方案，一生一计划”，针对学生不同的专业背景，在导师指导下，学生自主设定培养计划。

**2、特色化课程体系**

本科培养阶段，建立理论与实践一体、课程与项目融合、核心与个性并举的“五结合”课程体系；硕士/博士培养阶段，注重科教融汇和产教融合，构建核心课程群，实施“课堂教学+项目实践”相融合的教学模式，组建“课程首席教授+导师”的师资队伍，采用自主/灵活学习方式和多元化考核方式。

**3、本研贯通培养**

“强芯铸魂”计划打通本硕博各个阶段，以学期作为培养节点，开展全程关联、系统性强的项目式挑战性课程和创新性项目研究，以实现在确保培养质量的前提下，本研贯通无缝衔接，缩短培养周期。

**4、科教融汇与产教融合**

依托国家集成电路产教融合创新平台重点打造的集成电路设计、特色工艺制造和封装测试平台，以及电子薄膜与集成器件全国重点实验室拥有的材料制备、测试表征和微细加工的完整实验条件，开展项目式课程和创新研究。

依托行业头部企业和国家重点单位共建的实习实践基地，全面开展资源协同、师资交流、课程共建和联合培养，营造高校和产业深度融合的生态，建设校企协同育人共同体，培养未来引领集成电路产业发展的领军人才。

**5、“推免”研究生机制**

在本科三年级至四年级结束时，为入选该计划并完成专项计划本科阶段培养方案学习要求、品行表现良好的学生给予推荐免试读研究生的资格。

**6、目前培养情况**

2023年至今共选拔2020-2023级学生102人，分别来自电子、物理、自动化、信软、经管、光电、集电学院，其中攻读本博学位的43人，攻读本硕学位的59人。为每位入选学生配备“双导师”，校内学术导师1人，校外实践导师1人。该计划现有导师82人，其中校外导师分别来自于华润微电子（重庆）有限公司、四川航天电子设备研究所等单位。根据培养要求，为每位入选学生设定了个性化的培养方案。2020级“强芯铸魂”研究生在读学生26人，2021级“强芯铸魂”在读学生29人，全部获得推免攻读研究生指标，其中23人完成本科培养，提前进入研究生阶段学习；2022级在读学生27人提前进入毕设设计环节。